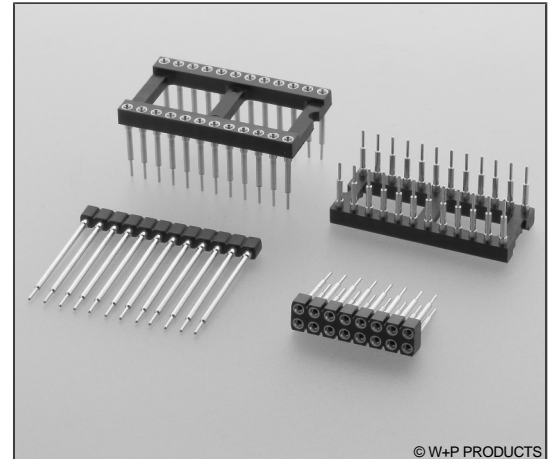


Abgesetzte IC-Fassungen / IC-Leisten RM 2,54mm - Bauhöhen 6,0–35,0mm Lifted IC Sockets / IC Headers 2.54mm Pitch – 6.0–35.0mm Profile

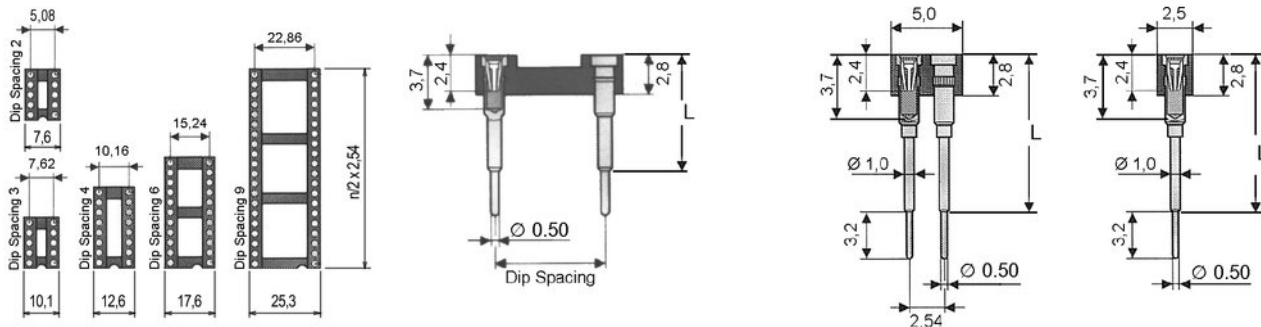
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (2 ... 3µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (2 ... 3µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.
For Ø0.40-0.56mm round pins
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



Series	Contacts*	DIP-Spacing*	Terminal*	Sleeve Plating	Clip Plating*
174	24	3	10	50	30
174 IC-Fassung IC-Socket	10 06/08/10/12/14/16/ 18/ 20/22/24/28 20/22/24/28/32 10/24/28/32/36/ 40/42/48/50/52 50/52/64	2 5,08mm 3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=6,0mm 20 L=8,0mm 30 L=10,2mm 40 L=12,0mm 45 L=13,5mm 50 L=15,0mm 60 L=18,0mm 70 L=22,0mm 80 L=29,0mm 90 L=35,0mm	50 Verzinnt Tin plated	10 0,25µm Gold 0,25µm gold plated 30 Vergoldet 0,75µm 0,75µm gold plated

Series	Contacts*	Rows*	Terminal*	Sleeve Plating	Clip Plating*
187	24	2	10	50	00
187 IC-Leisten IC Headers	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=6,0mm 20 L=8,0mm 30 L=10,2mm 40 L=12,0mm 45 L=13,5mm 50 L=15,0mm 60 L=18,0mm 70 L=22,0mm 80 L=29,0mm 90 L=35,0mm	50 Verzinnt Tin plated	00 Vergoldet Gold plated 10 Vergoldet 0,25µm (Option) 0,25µm gold plated (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

